



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091117001
2010 年 7 月 30 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP/ASP-MCU 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更のご案内

(第二版 PCN20091117001B 2010 年 6 月 29 日発行, 初版 PCN20091117001A 2009 年 11 月 24 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知の 30 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	ASP/ASP-MCU 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : Cu(銅)線 ボンディングワイア			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	9月上旬の出荷より予定しています。 (サンプルは2009年12月中旬の出荷より実施しています。)			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト)及びASP-MCU(マイクロコントローラ)一部製品について、現行 Au(金)線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、ボンディングワイアの機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為に、これに替えて、Cu(銅)線 ボンディングワイアへ移行し認定しました。下記の通り、既報製品より13製品を本変更対象から除外しています。それに伴い、信頼性試験代表製品を一部変更しています。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

ボンディングワイア

現行

Au(金)線

変更後

Cu(銅)線

理由：機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
□: 認定終了品 取消線/右詰: 対象除外品				
CXD9835ATNDBT	TAS5508APAGR	TMS320F28022DAT	TMS320F28035PAGT	TMS470R1A64PNT
DE017004APZA	TAS5508APAGRG4	TMS320F28022PTS	TMS320F28035PNS	TMS470R1B1MPGEA
DEF01000PBKA	TAS5508BPAG	TMS320F28022PTT	TMS320F28035PNT	TMS470R1B1MPGEAR
ES7110S	TAS5508BPAGG4	TMS320F28023DAS	TMS320F28044PZA	TMS470R1B512PGET
F741504PAG	TAS5508BPAGR	TMS320F28023DAT	TMS320F28044PZS	TMS470R1B768PGET
F741505APZT	TAS5508BPAGRG4	TMS320F28023PTS	TMS320F2806PZA	TMS470R1R384PZ-T
F741583A/P	TAS5508PAGR	TMS320F28023PTT	TMS320F2806PZS	TMSDVC5410APGER16
F741583APGF	TAS5508PAGRG4	TMS320F28026DAS	TMS320F2808PZA	TNETC4522EPYP
F741598PEF	TAS5518CPAG	TMS320F28026DAT	TMS320F2808PZS	TNETV115PAP
F741783PDQ	TAS5518CPAGR	TMS320F28026PTS	TMS320F2809PZA	TNETV115PAPR
F741814APBL-1	TAS5518PAG	TMS320F28026PTT	TMS320F2809PZS	TNETV2840F1DPGF
F741824PGF	TAS5518PAGG4	TMS320F28027DAS	TMS320F2810PBKA	TNETV2840PGF
SBF2808PZA	THS8135PHP	TMS320F28027DAT	TMS320F2810PBKS	TVP5146M21PFP
SF2806PZA	THS8135PHPG4	TMS320F28027PTS	TMS320F2811PBKA	TVP5146M2PFP
SNO407137PAGR	THS81361PHP	TMS320F28027PTT	TMS320F2811PBKS	TVP5146PFP
SNO502003PBSR	THS81361PHPR	TMS320F2802PZA	TMS320F2812PGFA	TVP5147M11PFP
SNO505063PAGR	THS8136PHP	TMS320F2802PZA-60	TMS320F2812PGFAG4	TVP5147M11PFP
SNO801033PAGR	THS8136PHPR	TMS320F2802PZS	TMS320F2812PGFS	TVP5147PFP
SN606070PAG	TMS320ACLPGF	TMS320F2802PZS-60	TMS320F28232PGFA	TVP5150AM11PBS
TAS3103ADBT	TMS320C2810PBKA	TMS320F28030PAGS	TMS320F28234PGFA	TVP5150AM11PBSQ1
TAS3103ADBTG4	TMS320C2811PBKA	TMS320F28030PAGT	TMS320F28235PGFA	TVP5150AM11PBSR
TAS3103ADBTR	TMS320C2812PGFA	TMS320F28030PNS	TMS320F28332PGFA	TVP5150AM11PBSRQ1
TAS3103DBTR	TMS320C54V90BPGE	TMS320F28030PNT	TMS320F28334PGFA	TVP5150PBSR
TAS3103DBTRG4	TMS320F28015PZA	TMS320F28031PAGS	TMS320F28335PGFA	TVP5150PBSRG4
TAS3108DCPR	TMS320F28015PZS	TMS320F28031PAGT	TMS320R2811PBKA	TVP5151PBS
TAS31081ADCP	TMS320F28015PZSR	TMS320F28031PNS	TMS320R2812PGFA	TVP5151PBSR
TAS31081ADCPR	TMS320F28015ZGMA	TMS320F28031PNT	TMS320VC5407PGER	TVP5154A1PNP
TAS3202PAG	TMS320F28016PZA	TMS320F28032PAGS	TMS320VC5409APGE12	TVP5154A1PNPR
TAS3204PAG	TMS320F28016PZS	TMS320F28032PAGT	TMS320VC5410APGE12	TVP5154APNP
TAS3204PAGR	TMS320F2801PZA	TMS320F28032PNS	TMS320VC5441PGF	TVP5154APNPR
TAS32081PZP	TMS320F2801PZA-60	TMS320F28032PNT	TMS320VC5441PGFG4	TVP5154APNP
TAS3208PZP	TMS320F2801PZS	TMS320F28033PAGS	TMS470R1A128PZ-T	TVP5154APNPR
TAS3208PZPR	TMS320F2801PZS-60	TMS320F28033PAGT	TMS470R1A256PZ-T	TVP5160M1PNP
TAS32181PZP	TMS320F280200DAT	TMS320F28033PNS	TMS470R1A256PZ-TR	TVP7000PZP
TAS32181PZPR	TMS320F280200PTT	TMS320F28033PNT	TMS470R1A288PGEA	TVP7000PZPR
TAS3218PZPR	TMS320F28020DAT	TMS320F28034PAGS	TMS470R1A288PGET	TVP7001PZP
TAS5504APAG	TMS320F28020PTT	TMS320F28034PAGT	TMS470R1A288PGETR	TVP7001PZPR
TAS5504APAGR	TMS320F28021DAT	TMS320F28034PNS	TMS470R1A288PZ-T	TVP700251PZP
TAS5504PAG	TMS320F28021PTT	TMS320F28034PNT	TMS470R1A384PGET	TVP700251PZPR
TAS5504PAGR	TMS320F28022DAS	TMS320F28035PAGS	TMS470R1A384PZ-T	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 9 日	終了	2010 年 6 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320F28015PZA	-	-	
Wafer Fab:	DM5	Wafer Technology:	1833C05.2	
Assembly Site:	TIPi	Package Code/Pins:	PZ/100	
Mount Compound:	Hitachi EN4085S2K3	Mold Compound:	Hitachi CEL9200HF-13	
Wirebond:	0.96mil Cu	Moisture Level:	JEDEC L-2/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot 2	Lot 3
**Storage Bake	170C, 420 Hours	90/0	90/0	90/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500cyc	90/0	90/0	90/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	189/0	226/0	759/0
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-2/260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 9 日	終了	2010 年 6 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TMS320F2812PGFA	-	-	
Wafer Fab:	DM5	Wafer Technology:	1833C05.2	
Assembly Site:	TIPi	Package Code/Pins:	PGF/176	
Mount Compound:	Hitachi EN4085S2K3	Mold Compound:	Hitachi CEL9200HF-13	
Wirebond:	0.96mil Cu	Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot 2	Lot 3
**Storage Bake	170C, 420 Hours	90/0	90/0	90/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500cyc	90/0	90/0	90/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	220/0	225/0	228/0
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3/260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 9 日	終了	2010 年 6 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TVP5147M1PFPR	-	-	
Wafer Fab:	DMOS5	Wafer Technology:	1833C05.4	
Assembly Site:	TAI	Package Code/Pins:	PFP/80	
Mount Compound:	Hitachi EN4085S2K3	Mold Compound:	Shinetsu KMC3580HB	
Wirebond:	0.96mil Cu	Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot 1	Lot 2	Lot 3
**Storage Bake	170C, 420 Hours	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	813/0	814/0	794/0
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3/260C				